

(China)

Huaxinbang Technology creates a new era of heterogeneous integration. The HIM heterogeneous integration module derived from Chiplet heterogeneous integration technology empowers Kongke Microelectronics' new track. – January 17, 2024

华芯邦科技开创异构集成新纪元，Chiplet异构集成技术衍生HIM异构集成模块赋能孔科微电子新赛道

[华芯邦科技](#) · 来源: jf_80856167 · 作者: jf_80856167 · 2024-01-18 15:20 · 208次阅读

Chiplet技术从[半导体](#)产业链分工上，属于先进封装技术。要实现 Chiplet这种高灵活度、高性能、低成本的IP 重用模式，首先就要具备先进的[芯片](#)集成封装技术。此外，我国异构集成行业内主流企业包括：华芯邦[科技](#)、Etron [Technology](#)、TSMC、EV Group等。其中，深圳市华芯邦科技有限[公司](#)是国内少数能够覆盖[模拟](#)电路、[数字](#)电路技术两大领域的芯片系统及解决方案的设计企业，其拥有的芯片异构集成技术为消费类[电子产品](#)行业带来了革命性的变革，还将积极探索更多行业领域的应用。

随着消费类[电子产品](#)不断升级，对芯片的集成度和性能要求也越来越高。为了满足这一需求，华芯邦科技推出了芯片异构集成技术，将不同工艺节点、不同材料、不同结构的芯片集成到一个封装内，实现了高度的功能集成和性能优化。这一技术的应用，使得芯片的体积更小、性能更高、功耗更低，为消费类电子产品的设计提供了更多的选择和便捷。

与此同时，华芯邦科技还将这一技术应用于HIM异构集成模块中伴随着[集成电路](#)和微电子技术不断升级，行业也进入了新的发展周期。HIM异构集成模块化-是华芯邦集团旗下公司深圳市前海孔科微电子有限公司KOOM的主营方向，将[PCBA](#)芯片化、异构集成模块化真正应用于消费类电子产品行业。这一技术的应用，使得产品的设计更加便捷、高效，提高了集成度和可靠性。不单单是产品内某一个[元器件](#)的优化，而是结合原产品本身做了深度的融合，利用本身多年来集成电路与微电路领域的研发能力，与先进封装能力如目前半导体行业高门槛技术2.5C/3D封装等，装肉眼可见与不可见的内部结构简化，性能优化，做到真正的高集成。

对于中国半导体产业而言，由于封装技术往往是由封装企业来主导，因此，Chiplet等先进技术仅由封装厂来操作就有一定的困难，缺乏国际上Fabless企业、晶圆代工企业互相配合积累的“know-how”，而深圳市华芯邦科技有限公司正在朝这一步伐稳健前行。不过，半导体产业有着“需求产生-供不应求-价格上涨-扩充产能-产能过剩-价格下跌-重新洗牌”的周期规律。我们也不单把弯道超车的念想放在一项Chiplet技术上，也会从点到面相结合突破。在行业周期下行之时，更多半导体企业只要找准新技术风口，抓住重新洗牌的机会，将自身的“软实力”和“硬实力”两手抓，未尝不能弯道超车。

审核编辑 黄宇

[阅读全文](#)

声明：本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人，不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用，如有内容侵权或者其他违规问题，请联系本站处理。[举报投诉](#)

<https://www.elecfans.com/d/2371567.html>